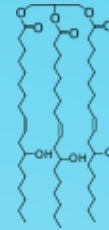


ひまし油変性エポキシ樹脂

EPOX MK R151

特徴/Characteristic

ビスフェノールA型エポキシ樹脂にひまし油で変性した100%反応性の可塑型高粘度液状エポキシ樹脂です。
非常に柔軟な特徴を持ち、曲げ弾性はビスフェノールA型樹脂硬化物の1/3です。
可撓性付与成分として使用されることもあり
また、常温又は加熱硬化で圧縮強度が高く耐衝撃性に優れた硬化物性が得られます。



This is 100% reactive plastic type high viscosity liquid epoxy resin modified with bisphenol A type epoxy resin with castor oil.
It has very flexible characteristics and flexural elasticity is 1/3 of bisphenol A type resin cured product.
Moreover, cured physical properties with high compressive strength and excellent impact resistance can be obtained at room temperature

組成・成分情報/ Composition・ingredient information

Chemical name or generic name	Concentration	Chemical formula	CAS-No
Bisphenol A type Epoxy resin	25%	Unpublish	25068-38-6
Bis-F Type	75%	Unpublish	68513-59-7

基本特性 / Basic characteristics

Shape	EEW g/eq	Viscosity mPa	Total-Cl %	Gardner	Flash point ℃	Solvent Solubility
Liquid	400~ 600	30,000~ 50,000	0.5	3	216	○

用途例 / Application exampe

可撓性塗料、電気注型、高剥離強度用接着剤、高圧トランス絶縁樹脂の添加剤など

硬化物性比較/Comparison of cured physical properties

	Test method	unit	R151	Bis-A
荷重たわみ温度	JIS K 7197-2	℃	23	148
Flexural Strength	JIS K 7171	Mpa	35	128
Flexural Modulus		Mpa	1060	2800
Tensile strength	JIS K 7162	Mpa	21	84
Tensile Modulus		Mpa	824	2600
Tensile fracture strain		%	51	9
IZOT衝撃強度 Impact strength	JIS K 7110	KJ/m2	2.3	2.1
Surface resistivity	JIS K 6911	X 10 ¹⁶ Ω	8	5
Dielectric breakdown	JIS C 2110-1	KV/mm	24	26

硬化条件

硬化剤：ホルカチド 0.7% 酸無水物 硬化促進剤 : PX-4MP

配合比 Epoxy/Hadner/Catalist → 100/90/1

硬化条件 100℃ * 3H → 170℃ * 3H → 冷却

上記数値は参考値であり保証するものではありません

透明・低粘度・柔軟性エポキシ樹脂

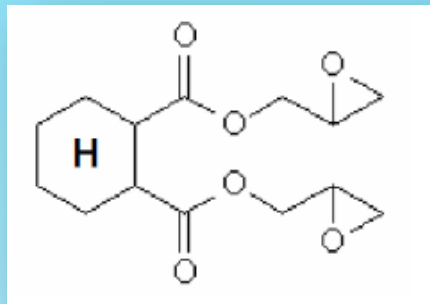
EPOX MK R540

特徴/Characteristic

無水ヘキサドリン酸のジグリシジルエステル系の透明・低粘度・柔軟性のエポキシ樹脂です。

This is epoxy resin with transparency・low viscosity・flexibility.

構造式/structural formula



組成・成分情報/ Composition・ingredient information

Chemical name or generic name	Concentration	Chemical formula	CAS-No
1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジグリシジル 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(oxiranylmethyl) ester; Diglycidyl hexahydrophthalat	≦99%	C14H20O6	5493-45-8

基本特性 / Basic characteristics

Shape	EEW g/eq	Viscosity mPa	Total-Cl %	Gardner	Flash point °C	Solvent Solubility
Liquid	155~170	350~550	1.0	1	214	○

硬化物性比較/Comparison of cured physical properties

	Test method	unit	R540	Bis-A
荷重たわみ温度	JIS K 7197-2	°C	102	148
Flexural Strength	JIS K 7171	Mpa	137	128
Flexural Modulus		Mpa	3240	2800
Tensile strength	JIS K 7162	Mpa	90	84
Tensile Modulus		Mpa	3080	2600
Tensile fracture strain		%	9	9
IZOT衝撃強度 Impact strength	JIS K 7110	KJ/m2	2.7	2.1
Surface resistivity	JIS K 6911	X 1016Ω	5	5
Dielectric breakdown	JIS C 2110-1	KV/mm	24	26

硬化条件

硬化剤：ヘキサドリン酸無水物 硬化促進剤：PX-4MP

配合比 Epoxy/Hadner/Catalist → 100/90/1

硬化条件 100°C * 3H → 170°C * 3H → 冷却

用途例 / Application exampe

LED封止剤、接着剤、液晶関連封止用途など

LED sealant, adhesive, liquid crystal related sealing applications, etc.

上記数値は参考値であり保証するものではありません

ゴム変性固形エポキシ樹脂 EPOX MK SR35K / SR3542

特徴/Characteristic

この樹脂は、変性ゴム配合の固形エポキシ樹脂です。
エポキシ樹脂の持つ防錆力と耐薬品性に加えて、ゴム変性による塗膜の伸び、造膜時の性に優れ、可撓性、耐衝撃性が向上します。

This resin is solid epoxy resin with modified rubber compound.
In addition to the rust prevention and chemical resistance of the epoxy resin, it is excellent in elongation of the coating film due to rubber modification and film forming properties, Improves flexibility and impact resistance.

組成・成分情報/ Composition・ingredient information

Chemical name or generic name	Concentration	Chemical formula	CAS-No
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, carboxy-terminated, polymer with bisphenol A diglycidyl ether	93%	(C ₂₁ H ₂₄ O ₄ .C ₄ H ₆ .C ₃ H ₃ N) _x	68648-83-9
Bisphenol A type Epoxy resin	5-7%	Unpublish	25068-38-6

基本特性 / Basic characteristics

Shape	EEW g/eq	Viscosity mPa	Total-Cl %	Gardner	SP °C	Solvent Solubility
solid	950-1200	W-Z	0.3	5	96	○

基本物性 / Basic properties

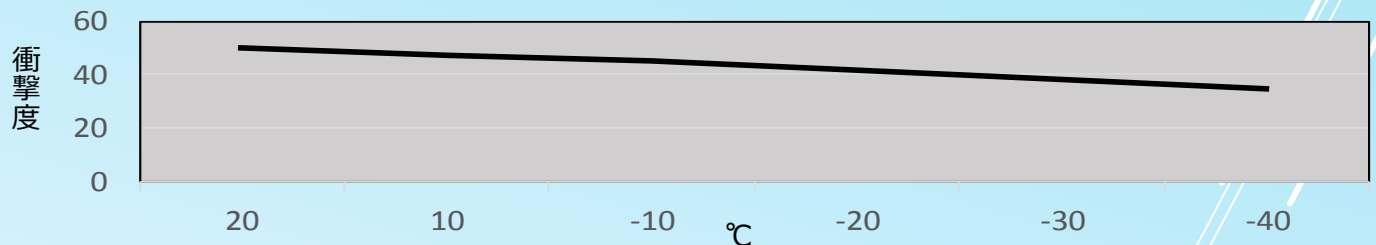
Flexural Strength (M P a)	Flexural Modulus (M P a)	Growth rate (%)	T G (°C)
114	4890	20	94

硬化条件

硬化剤 : DICY 硬化促進剤 : TiO₂ 配合比 Epoxy/Hardner/Catalist → 100/4/50
硬化条件 230°C * 7min(Draw up) → 230°C * 10min(Baking) Thickness 350 μ

耐衝撃試験 (鉄板厚み9mm 膜厚 300~500μm)

Impact resistance test (iron plate thickness 9 mm film thickness 300 to 500 μm)



溶解性試験/Solubility test (25°C)

Solvent Solubility	Acetone (W t %)	MEK (W t %)	P G M (W t %)	PGMAK (W t %)	IPA (W t %)
SR35K/SR542	65	65	45	40	5

上記数値は参考値であり保証するものではありません